

珠海全志科技股份有限公司

2025 年度总经理工作报告

各位董事：

报告期内，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，推动各项工作有序开展。我谨代表公司管理层对2025年度工作情况进行总结，具体如下：

一、2025年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入283,795.39万元，比上年同期增长24.04%，归属上市公司股东的净利润26,213.26万元，比上年同期增长57.20%。

二、2025年度主要工作回顾

公司坚持在新技术、新芯片、新应用上持续高强度的投入，不断在智能汽车电子、工业控制、消费电子等领域积极拓展新市场、新客户、新应用，公司新产品及新方案顺利量产，推动公司业绩增长。

1. 用技术创新提升产品竞争力

（1）持续打造高性能通用异构计算平台

随着人工智能技术的迅猛发展，对高算力、异构集成、高带宽及极致能效的需求呈指数级增长，公司致力于构建序列化的通用异构计算平台和产品矩阵，全面推动各领域的智能化升级。

报告期内，公司通过深度优化总线架构、智能调度算法及底层操作系统，成功实现了涵盖CPU、GPU、NPU、DSP及RISC-V协处理器的复杂异构芯片规模化量产，标志着公司已具备提供灵活算力组合策略的能力，能够精准匹配不同应用场景的差异化需求。在ARM架构上，公司已完成多档位高性能处理器布局，包括八核A55、八核A73+A53、八核A76+A55等多档位布局；同时积极探索RISC-V处理器在协处理器和主处理器的应用，构建自主可控的算力底座。在音频处理领域，借助HiFi4、HiFi5等DSP算力补充，充分满足了多样化的音频应用需求。面向未来，公司正积极布局前沿技术，持续攻坚高算力平台，探索100K+ DMIPS CPU算力、512G+ Flops GPU算力及10T+ Flops NPU算力的

技术突破，开展Chiplet（芯粒）技术研究，以提升芯片集成度与性能灵活性；推进AI融合的8K超高清编解码及显示技术研发，为超高清多媒体持续赋能；深耕高速互联技术，开展高速率SerDes的研究，为下一代高性能计算平台奠定坚实基础。

（2）完善AI算法及应用落地

公司继续深耕视觉、语音、显示及人机交互等典型场景，积极储备并适配各类AI算法，拓展其在各细分领域的应用落地；通过推动硬件、软件与算法的协同升级，持续优化场景体验，驱动各领域的进步与创新。

在视觉技术方面，公司持续深化ISP与AI的融合，旨在提升视觉体验、降低能耗并拓宽应用场景。在视觉体验上，新一代AI-ISP针对低照度环境优化算法，在同等信噪比条件下，实现感光度2~4倍的提升，显著改善暗部色彩还原及噪点控制表现。在能效表现上，新一代AI-ISP使内存占用及带宽需求降低近30%~50%。在安防应用场景中，公司不断丰富AI算法库，在既有人脸/人形检测与识别、人形追踪、车辆/包裹/宠物检测等基础算法之上，新增自研的“AI人车宠三合一监测”、“AI婴儿躺床监测”及“AI人车周界防范”等算法；同时，利用AI SR算法对红外成像技术进行定向优化，提升热红外成像画质，以满足社会管理与家庭看护等多样化需求。在拍照摄影场景中，推出了AI ISP智能成像、AI夜景人像、AI超清图像、AI美颜、AI人像虚化、AI抠图及AI魔法换天等功能，显著提升了画质表现与创作自由度。

此外，公司将提速AI视觉在端侧的落地，覆盖摄影摄像、视频通讯、智能车载、机器人感知及工业检测等多元场景，全力推动AI视觉降噪、AI图像检测及AI视觉识别等算法的商用化进程，构建端侧智能新生态。

在超清显示技术方面，公司通过AI与传统算法的深度融合，持续提升显示体验。针对海量互联网片源帧率低而显示设备刷新率高，进而导致播放卡顿、流畅度不足的痛点，公司利用异构算力并行加速实现了AI MEMC（AI 运动补偿）技术，支持任意分辨率与帧率的片源输入，实时智能插帧输出60fps视频，大幅提升观影流畅度。同时，面向云电脑、移动设备及商业显示等场景中低清晰度视频的播放需求，持续优化AI SR超分辨率技术，可实现将480P视频超分至4K分辨率。

（3）升级核心技术完善细分领域产品系列

在通用计算平台的基础上，公司紧扣细分领域客户的痛点，依托统一、高效且高质的技术研发平台，快速迭代芯片产品与解决方案，持续推动各细分领域的核心技术升级与产品矩阵完善。

在智能平板领域，公司完成新一代普惠型智能平板芯片A333的验证，并规模量产，与原有A1X系列，A5X系列和A7X系列平板芯片形成更加完整产品矩阵，并全面通过Google Android 16 GMS Express认证。同时，公司启动新一代A7X系列芯片的升级与迭代工作，旨在进一步提升产品体验和竞争力。

在机器人和工业控制领域，公司发布新一代控制型机器人芯片MR153，并开始在客户项目中进行试量产。该芯片搭载四核ARM处理器与专用RISC-V实时处理器，以及丰富的UART、PWM、GPIO等接口资源，能够更精准地支持红外传感器、陀螺仪、超声波、线激光及ToF等多种传感器接入，提升实时运算与控制性能。目前，公司已在机器人领域完成MR153、MR527、MR536的序列化布局。

在工业控制和人机交互领域，公司发布新一代工业专用控制芯片T153，可用于工业PLC、工业HMI，工业网关及电力应用。该芯片搭载四核ARM处理器与专用RISC-V实时处理器，配备三个千兆以太网口、双CAN-FD接口及LocalBus，支持高吞吐量网络连接，完美契合复杂数据驱动型应用需求。此外，T153提供24路GPADC、6路TWI接口及30路PWM等丰富外设，提升了自动化系统的集成灵活性与扩展性；配套的多核AMP架构软件开发包，则充分满足了工业自动化对高实时性的严苛要求。

在智慧视觉领域，公司完成新一代智慧安防芯片V861验证和试产。V861全面升级了AI-ISP图像处理单元与H.264/H.265编码器，具备4K高清视频处理能力，并支持三路摄像头直连。V861还集成了全自研NPU内核AWNN100，为AI算法的支持和场景的落地提供了更好的支撑。除此之外，公司发布了新一代AI智能眼镜芯片V881，并完成回样进入验证环节，V881在V821智能眼镜芯片基础上升级编码能力到4K30fps，具备2千万拍照能力和更好的图像处理能力，同时升级无线能力到WiFi6来提高传输效率和用户体验。目前，公司已在智能视觉领域形成V821、V831、V851、V861、V881的完整序列化布局，实现了从2M到8M市场的全面覆盖。

在智能解码显示领域，公司完成了第二代智能投影芯片H723系列和面向超微型投影的H135系列的产品发布和规模量产，并完成面向高性能海外视频认证机顶盒芯片H626和智能投影芯片H736的流片和回样。H723定位智能投影芯片，支持8K24fps的解码能力并提供多种显示输出接口；H135定位微型投影芯片，具备1080P视频解码和显示输出能力；H736定位海外视频认证投影芯片，支持AV1硬件解码器，并升级到4核A55 CPU和G310 GPU架构，提升产品性能和用户体验；H723、H736以及H135全系均内置的硬件梯形校正引擎，有效提升了UI刷新率，降低了画面锯齿与输入延迟，改善了投影体验。

在智能解码机顶盒领域，公司发布面向海外视频认证及运营商机顶盒芯片H626，采用四核A55 CPU与G310 GPU架构，并支持AV1解码器与新一代安全架构，支持HDMI 2.1输出接口和USB3.1接口，填补了公司海外认证机顶盒市场的空缺。

（4）SoC周边芯片配套，提升方案竞争力

随着公司产品下游应用版图的持续扩张，各类应用场景对配套芯片及整体解决方案的需求日益迫切。为此，公司持续加大研发投入，加速推出高性能配套产品，以构建更具竞争力的“SoC+配套芯片”产品生态。

在无线产品领域，公司成功完成首颗支持2.4G/5.8G双频、80M频宽的WiFi6和双模蓝牙5.3 Combo芯片的投片与验证工作，并进入客户试产阶段。

在电源管理与电量监测领域，支持PD 3.0协议的快充芯片AXP517与高精度电量计芯片AXP2602已实现大规模量产，同时为安防领域产品推出专用电源管理芯片AXP333并进入推广阶段。

2. 深耕应用市场，完善产业布局

报告期内，公司在主要应用市场业务开展情况如下：

（1）机器人与工业控制

随着人工智能技术的持续发展，人工智能技术也在助力推动工业智能化升级和机器人智能化升级，而感知力、认知力、控制力升级成为未来产品发展的主要方向。

在机器人领域，公司AI机器人芯片MR536，已成功导入多家行业头部客户及核心方案商。基于该芯片打造的多款扫地机器人产品、割草机器人等机器人产品，凭借融合感知、视觉避障、高精度地图定位及混合清洁力等卓越性能相继上市并实现大规模出货。同时，依托新一代控制型机器人芯片MR153，公司与多家头部客户联合开发了入门级服务机器人产品及专用控制模块，目前相关产品已顺利量产，进一步丰富了公司在机器人领域的产品梯队。

在工业控制领域，公司推动高性能芯片T536和控制型芯片T153在行业头部客户中的落地应用，相关产品形态涵盖电力设备、PLC、工业网关、3D打印机、工业HMI及工业边缘计算设备等多元化场景。目前，搭载T536和T153的工业开发板均已上市销售。凭借卓越的性能表现、高可靠性及广泛的场景适应性，T536在中国工控网主办的“中国自动化+数字化产业年会”中荣获“工业芯新质奖”，充分体现了公司在智慧工业领域技术实力和产品创新能力。同时，公司积极拥抱工业开源生态，参与开源社区活动，适配国产开源鸿蒙操作系统，并获得了开放原子开源基金会授予的生态产品兼容证书。

在第25届中国国际工业博览会上，T536斩获工博会“集成电路创新成果奖”。

（2）发挥算力及性价比，布局车载驾舱

智能汽车电子市场，公司全面深化与主流车企的合作，重点推动基于T527V平台的前装定点项目方案落地，巩固了现有合作成果的同时，成功拓展了多家新客户及多个新项目。面向更高性能需求的T736智能座舱方案已开始交付，并正与多家头部车企开展新一轮定点项目的洽谈。

公司将持续围绕这两个平台，推动芯片方案在前装智能驾舱领域的量产。截至目前，通过积极和国内头部车企开展研发合作，公司已积累了智能座舱、全数字仪表、AR-HUD、智能激光大灯、智能辅助预警等多种智能模块解决方案。随着大模型技术的逐步成熟，未来公司将积极探索大模型在车载智能化应用的机会，并投入研发相关技术和产品，把握全车智能化的产业机遇，为全车智能化的进程助力。

（3）围绕平台芯片，深耕平板及行业应用

通用智能终端市场，安卓生态的持续演进已成为驱动行业发展的核心引擎。

一方面，公司持续完善高性能智能终端芯片的产品矩阵，不断拓展应用版图。报告期内，搭载八核A73+A53处理器的A537芯片已率先在智能平板市场实现大规模量产；凭借其在性能与功耗平衡上的卓越表现，该芯片在中端市场赢得了良好的市场反响，并进一步延伸至智能教育、智能家居等领域。同时，搭载八核A76+A55处理器的A733芯片，在稳固智能平板大规模量产的基础上，积极与核心客户联合开发教育平板、商显设备、收银终端及云电脑等应用场景；目前，相关产品已正式量产并处于稳步爬坡阶段。

另一方面，公司深度整合AI技术，积极推动智能终端向“+AI”方向迭代升级，以满足各行业从传统计算向智能计算跨越的需求。公司紧密联动生态合作伙伴，依托A733强大的CPU+GPU+NPU异构算力，在智能平板、教育平板等应用中，积极开发并适配了AI超分、AI画质增强、智能语音交互、AI辅助学习等AI技术，成功量产了多款具备差异化竞争力的“+AI”型产品，显著提升了用户体验与产品附加值。未来，公司将持续推动传统智能终端向具备主动感知、深度学习及智能决策能力的AI型智能终端升级。

（4）解码与家庭娱乐

智能机顶盒市场，受益于海外视频播放需求的增长，公司H313和H618系列产品凭借其优异的多媒体播放能力和兼容性，获得良好市场反应。搭载了2T NPU的八核智能媒体处理器H728已实现大规模量产，进一步丰富了高端产品线。面向海外高清内容认

证的第三代机顶盒芯片H626也顺利完成流片并回样，为拓展全球市场奠定了坚实基础。

智能投影市场，随着单片LCD投影光机技术的日益成熟，家用投影机的销量持续快速增长。报告期内，公司推出了超微型投影芯片H13X系列与第二代智能投影芯片H72X系列。凭借优秀的画质表现及公司自研的硬件梯形矫正引擎，获得了客户的认可，实现大规模量产，成为智能投影市场主流方案。此外，支持海外内容认证的第三代智能投影芯片H736也已完成流片及回样验证，将助力公司进一步扩大在智能投影领域的影响力。

智能电视市场，第一代TV303芯片成功量产后，为满足智能电视市场的升级需求，公司已完成了第二代智能电视芯片TV323的样品验证，并开始向下游客户推广。

（5）智慧视觉与安防应用

智慧视觉与安防市场，报告期内，V821凭借较好的性能和较高的集成度，覆盖数十家安防核心客户，并快速实现了大规模量产和持续增长；同时，由于其完善的方案和产品体验，V821智能眼镜解决方案成为眼镜量产方案中的主流方案，获得了眼镜穿戴市场的青睐和认可，并完成百万级别量产；新产品安防芯片V861和影像芯片V881在性能，画质和功耗方面均全面升级，同时凭借其产品包高度的继承性，客户端也在快速的导入和开发。

针对安防和影像视觉产品和场景，公司在影像降噪技术，防抖和对焦技术，以及图像超分技术上都实现了新的升级和应用落地，加速了市场领域的拓展。在智能穿戴领域，视觉眼镜与穿戴产品，实现百万级量产规模；在智能出行领域，打造多款行车记录仪爆款产品；在智能教育领域，推出系列化AI相机拍学产品；在智能安防领域，构建起覆盖室内至室外的全方位监控产品体系。至此，公司已成功构建“人、车、家”全场景视觉产品布局，形成了覆盖全档位、多领域的丰富视觉产品货架。

三、2026年度经营计划

围绕公司的战略规划，2026年公司制定了各项经营措施，以保证公司持续、健康的发展。具体如下：

1. 市场方面

促进消费电子及泛智能产品的增长。在2025年，公司发布智能平板芯片A133的升级产品A333，丰富了入门级平板的产品选择，提升了产品性能和体验，并与中高端平板芯片A523、A537、A733一起形成完整的产品阵列，给不同定位的客户和市场丰富的选择，满足如平板、笔电、云电脑、电子相框、商显、收银、移动屏等各种高、中、

低档位的应用需求，公司将继续扩大完善软硬件方案，加强与各细分产品领域的头部客户合作，扩大应用群体，实现消费电子领域的稳步增长。

加速在工业和机器人领域的落地。2025年，继高端工业芯片T536发布之后，公司再次发布面向工业入门级的智能专用芯片T153，完成了专用工业芯片的高低搭配，公司将继续围绕工业PLC、工业HMI、工业网关、工控机及电力和能源等领域完善工业解决方案并深化应用场景落地，扩大T153和T536在工业客户项目中的应用，以此来为中国工业芯片贡献方案；在机器人领域，MR153的发布完善了智能扫地机普惠档的支撑，和MR100、MR813、MR527、MR536一起形成了机器人档位的全面覆盖，公司将继续推动机器人感知和控制技术在各品牌和大客户中的项目落地，并积极开拓其他产品如割草机、商用机器人、物流机器人、具身机器人以及各类特种机器人等领域的应用。

推进智能解码海外认证产品的落地。公司H系列机顶盒及投影产品在公开市场获得良好市场反应，并将持续开拓国内外品牌客户和运营商认证市场空间。2025年，公司面向认证市场的智能投影芯片H736和智能机顶盒芯片H626已进入验证阶段，公司将在2026年集中围绕认证方案和客户需求，加速推进产品通过认证，实现量产。同时公司将继续推进高端投影和机顶盒市场的芯片研发工作。

扩大视觉产品在安防和影像市场空间。随着V821的量产和V861的发布，公司V系列视觉产品已经形成从2M到4K产品的覆盖，并在安防摄像头、车载记录仪、AI眼镜、运动相机等多个领域成为主流方案。2026年，公司将继续扩大V系列新产品的量产工作，在安防、车载和影像穿戴市场开发新方案，耕耘新客户，实现稳步增长；同时，公司将继续在4K更高端档位投入芯片研发工作，实现高端产品的覆盖。

深耕车载及智能驾舱应用。2025年，公司车载芯片T527V已通过车规AEC-Q100认证，并在前装定点项目中获得量产。2026年，公司将继续围绕智能驾舱场景，继续深耕车载头部客户，围绕定点项目推动量产落地，持续开拓品牌方案，实现更多产品覆盖。

2. 研发方面

为了满足不断增长的AI应用场景需求，公司将持续优化和完善算力架构、NPU设计、先进工艺和封装技术，推出更具竞争力的智能产品，从而满足AI技术在智能硬件、工业、行业、安防等各领域的应用。

针对各产品线产品，公司将在通用计算、智能平板、智能解码、智能编码和多媒体领域推出新的升级或迭代产品，丰富产品矩阵；面向视觉计算领域，公司将推出基于第三代AI-ISP技术和第二代自研NPU核心的新一代高端视觉计算芯片，实现端侧AI的

产品布局；面向AIOT领域，公司将投入更大算力平台的研发工作，以满足未来端侧计算的需求。

除此之外，公司将继续在SoC周边配套芯片进行扩充和迭代，发挥产品包组合优势，并在软件系统方案和生态平台建设方面加大研发投入和开放力度，实现生态的共创共赢。

在知识产权方面，公司在已有的资产积累和管理方法基础之上，将继续提升知识产权的保护和利用意识，及时转化技术创新为知识产权资产，为公司的产品线拓展提供支撑。

3. 质量方面

公司将继续围绕“质量竞争力领先”的质量战略目标，与客户和合作伙伴鼎力协作，共同构筑全业务链质量技术和质量管理的竞争力壁垒；以高标准牵引，坚持深化IATF 16949车规质量管理体系及5大质量工具，持续提升公司的质量管理能力，保障产品和服务的高品质交付；落实ISO 26262功能安全管理体系，为公司拓展车规级、工业级应用领域的业务提供强力保障。

4. 人力组织方面

紧密围绕公司战略发展目标，持续强化组织与人才竞争力的提升。通过组织结构优化和信息化技术，不断建设多区域、一体化、创新型组织，构建简单高效的团队协作方式。通过搭建高效的人才培养选拔机制，构建高端人才多元化的合作模式，推进人才结构不断升级。以奋斗机制为牵引，不断完善多元化激励机制和考评机制，激发人才活力，共享经营回报，多渠道助力员工个人发展与成长提升，稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。

特此报告。

珠海全志科技股份有限公司

总经理：叶茂

2026年3月26日